附件

2020年度杭州高新区（滨江）集成电路

产业政策申报材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申报单位（盖章） | ： |  |
| 联系人 | ： |  |
| 手机 | ： |  |
| 地址 | ： |  |
| 日期 | ： | 2020年XX月XX日 |

杭州高新区（滨江）经济和信息化局制

集成电路产业政策申报材料制作说明

1. 申报材料内容应实事求是，表述明确，表格需填写完整。
2. 所有申报材料按照以下顺序排列，添加页码、编制目录：
3. 集成电路申报企业基本情况表；
4. 财政扶持情况说明；
5. 贷款贴息申报情况表；
6. 集成电路申报汇总表；
7. 企业营业执照复印件；
8. 集成电路布图设计登记证书；

（七）2019年度审计报告；

（八）2019年度社保清单；

（九）相关合同、支付凭证和发票复印件。

1. 申报材料用A4纸双面印制、胶装成册并盖章（一式两份），同时提供电子版。

附表一

集成电路申报企业基本情况表

金额：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法人代表 |  | 注册地址 |  |
| 注册资本 |  | 注册时间 |  |
| 主营业务 |  | 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  | 联系人 |  |
| 传真 |  | 联系手机 |  |
| 主要股东(按股权比例列出前三名)及所占股权比例 | 股东名称 | 所占股权比例 | 是否风投资金 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2018 | 职工人数 |  | 其中：研发人员数 |  |
| 资产总额 |  | 负债总额 |  |
| 营业收入 |  | 其中：集成电路设计业务收入 |  |
| 利润总额 |  | 应缴税金 |  |
| 研发经费 |  | 年末账面实收资本 |  |
| 审计机构名称 |  | 审计机构分类管理等级 |  |
| 2019 | 职工人数 |  | 其中：研发人员数 |  |
| 资产总额 |  | 负债总额 |  |
| 营业收入 |  | 其中：集成电路设计业务收入 |  |
| 利润总额 |  | 应缴税金 |  |
| 研发经费 |  | 年末账面实收资本 |  |
| 审计机构名称 |  | 审计机构分类管理等级 |  |
| 企业所获资质或荣誉(市级以上) |
| 企业发展情况(企业发展历程、重大融资事件、本企业认定的其他重大事件。不超过500字) |
| 企业主要产品情况（其中，申请流片补助的产品必填）(产品主要功能、技术指标、行业地位以及主要应用服务领域。不超过800字) |
| 企业技术力量和人员结构(企业现有人力资源配置，包括企业管理人员、研发人员、销售人员的结构、基本情况，以及近年来取得的研发成果。不超过500字) |
| 企业现有设备、场地等经营条件（不超过300字） |
| 企业营销能力(企业经营模式和市场策划能力、销售渠道等。不超过300字) |

附表二

财政扶持情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称: | 金额：万元 |
|  | 扶持政策类别（国家、省、市、区专项名称） | 时间 | 项目名称 | 总投资 | 资助额 | 下达资金文件文号 |
| 获得国家、省、市、区各类财政资助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 企业当前正在申报其他各类财政资助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 企业承诺 | 本单位承诺：1、上述填列的内容真实完整； |
| 2、本次申报的各项资助与上述本单位已获得（申报）的各类财政资助在实施内容、投资额等方面不重复； |
| 3、如有不实，本单位愿承担相关责任。 |
|  |
|  法人代表签字： 单位盖章: |
|  |
|  年 月 日 |
|  |
| 注：扶持政策类别按下达资金文件中的类别填写，包括财政资助、奖励、补助等。 |

附表三

贷款贴息申报情况表

企业名称：

|  |
| --- |
| **贷款一：** |
| 贷款银行 |  | 贷款周期 |  |
| 起息日 |  | 结息日 |  |
| 贷款天数（天） |  | 贷款金额（万元） |  |
| 贷款利率（年利率） |  | 利息金额（万元） |  |
| 合同编号 |  | 还息凭证编号 |  |
| **贷款二：** |
| 贷款银行 |  | 贷款周期 |  |
| 起息日 |  | 结息日 |  |
| 贷款天数（天） |  | 贷款金额（万元） |  |
| 贷款利率（年利率） |  | 利息金额（万元） |  |
| 合同编号 |  | 还息凭证编号 |  |
| **贷款三：** |
| 贷款银行 |  | 贷款周期 |  |
| 起息日 |  | 结息日 |  |
| 贷款天数（天） |  | 贷款金额（万元） |  |
| 贷款利率（年利率） |  | 利息金额（万元） |  |
| 合同编号 |  | 还息凭证编号 |  |

附表四

集成电路申报汇总表

企业名称： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 申报内容 | 填写内容 |
| 房租补贴 | 总金额 | 社保缴纳人数 |
|  | （2019年底数） |
| 流片 | 总金额 | 发票编号 |
|  |  |
| 掩膜版 | 总金额 | 发票编号 |
|  |  |
| IP | 总金额 | 发票编号 |
|  |  |
|  |  |
| EDA | 总金额 | 发票编号 |
|  |  |
|  |  |
| 首购首用 | 总金额 | 发票编号 |
|  |  |

联系人： 联系手机：